(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年6 月14 日 (14.06.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/066610 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/324161

(22) 国際出願日: 2006 年12 月4 日 (04.12.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-355918 2005 年12 月9 日 (09.12.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 吉岡孝久 (YOSHIOKA, Takahisa) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 杉下芳昭 (SUGISHITA, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

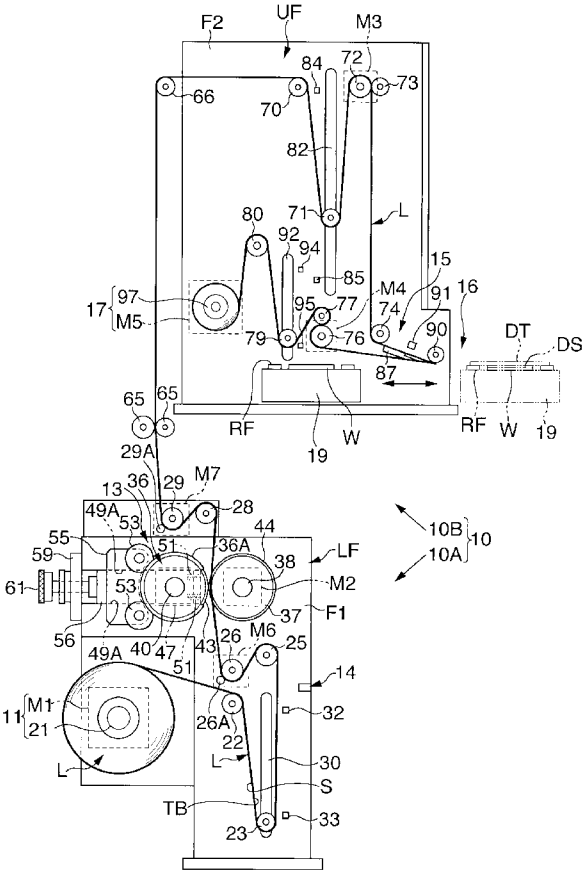
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

WO 2007/066610 A1

(54) **Title:** TAPE BONDING DEVICE AND TAPE BONDING METHOD

(54) **発明の名称:** テープ貼付装置及び貼付方法



(57) Abstract: A web (L) produced by temporarily bonding a band-like tape base (TB) having a die-bonding sheet section (DS) having a size corresponding to the shape of a semiconductor wafer (W) to a band-like releasable sheet (S) is fed. A cut detecting device (14) detects during the feeding whether or not any cut (C) is formed in the peripheral side of the die-bonding sheet (DS). If the cut detecting device (14) detects that a cut (C) is formed, a die cut device (13) passes the web (L) as it is without forming a cut (C). If the cut detecting device (14) does not detect any cut (C), the die cut device (13) forms a cut (C) to produce a bonding tape (DDT). The bonding tape (DDT) is released by a releasing device (15) and bonded to a ring frame (RF), with the die-bonding sheet (DS) aligned with the semiconductor wafer (W).

[続葉有]

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

帯状の剥離シート（Ｓ）に半導体ウエハ（Ｗ）の形状に対応する大きさのダイボンディングシート部（ＤＳ）を有する帯状のテープ基材（ＴＢ）が仮着された原反（Ｌ）を繰り出し、当該繰り出し途中で、ダイボンディングシート部（ＤＳ）の外周側に切り込み（Ｃ）が形成されているか否かを切り込み検出装置（１４）で検出する。この検出の結果において、切り込み（Ｃ）が形成されていると判断されたときは、ダイカット装置（１３）は切り込み（Ｃ）の形成を行うことなく原反（Ｌ）を素通りさせる。この一方、切り込み（Ｃ）が検出されないときは、ダイカット装置（１３）が切り込み（Ｃ）を形成して貼付用テープ（ＤＤＴ）を形成する。貼付用テープ（ＤＤＴ）は剥離装置（１５）で剥離され、ダイボンディングシート（ＤＳ）が半導体ウエハ（Ｗ）に一致した状態で、リングフレーム（ＲＦ）に貼付される。